

# 平成17年度(第19回) 「型技術者会議2005」プログラム

(一講演15分、討論5分 印講演者(敬称略))

## 6月15日(水)

| コンベンションホール1 (4F)  | コンベンションホール2 (4F)   | D 会議室 (6F)   | 小展示ホール (2F)   |
|---|--|--|---|
| <p>10:00~11:00<br/><b>切削加工機</b><br/>座長 今泉英明(オーエスジー株)</p>  | <p>10:00~11:00<br/><b>CAD/CAM/CAE</b><br/>座長 山本敏郎(日本エシス・エクセリュションズ株)</p>  | <p>10:00~11:00<br/><b>射出成形</b><br/>座長 津久井伸一(宮津製作所株)</p>  | <p>10:00~12:00<br/><b>特別企画</b></p>  |
| <p>101 小物精密金型加工用立形マシニングセンタ「NV1500DCG」<br/>川口廣晃(株)森精機製作所)</p> <p>102 5軸制御立形マシニングセンタ「V33-5XB」の開発と高精度・高能率金型加工<br/>中安和正(株)牧野フライス製作所)</p> <p>103 金型製作における多軸制御複合旋盤機の有効活用<br/>山口勝政、滝沢修、崎山転、清水基男(日産自動車株)、大森一典(株)ヤマザキマザック)</p> | <p>201 加工フィーチャ認識による金型加工の自動化<br/>池田宗弘、徳高敬浩、鰐淵好輝(倉敷機械株)</p> <p>202 放電加工機における自動化システムの最新事例紹介<br/>河合泰弘、千田慎吾(三菱電機株)、渡辺浩太郎(三菱電機メカトロニクスソフトウェア株)</p> <p>203 工具姿勢変化の連続性を考慮した5軸制御加工用工具経路生成法<br/>森重功一、若山広樹(電気通信大学)</p>               | <p>301 金型の温度上昇に関する考察 - 成形昇温時における金型のトラブルシューティング -<br/>鷹野肇(株)タカオ設計事務所)</p> <p>302 積層金型を用いた金型温度切替制御による射出成形のハイサイクル高精度化<br/>山崎久男、中川威雄(株)積層金型研究所)、鈴木政幸、サラスリカルド(株)三琇エンジニアリングサービス)、国枝正典、美里健一(東京農工大学)</p> <p>303 ホットランナーのカスケード開閉制御と超高速射出成形による超薄肉サンドイッチ成形技術の開発<br/>横井秀俊(東京大学国際・産学共同研究センター)、宿果英、和知忠道(東京大学大学院)、金藤芳典(東京大学生産技術研究所)</p> | <p>「気になる海外動向」</p> <p>司会<br/>牟田芳喜(トヨタ自動車株)、瀧口雅人(日産自動車株)</p> <p>講演者<br/>横田悦二郎(黒田精工株)<br/>高城祐二((有)ザ型屋ドットコム)<br/>浅井敬一郎(愛知淑徳大学)<br/>滝沢英男((有)タキザワ・コンサルティング)</p> |
| <p>11:10~12:10<br/><b>切削加工</b><br/>座長 森重功一(電気通信大学)</p>  | <p>11:10~12:10<br/><b>CAD/CAM/CAE</b><br/>座長 山本敏郎(日本エシス・エクセリュションズ株)</p>  | <p>11:10~12:10<br/><b>鍛造</b><br/>座長 津久井伸一(宮津製作所株)</p>  | <p>(内容の詳細は別紙をご覧ください)</p>  |
| <p>104 磨きレス加工実現の要件<br/>阿部東甫(サンドビック株)</p> <p>105 超硬ボールエンドミルによる高速・高精度加工<br/>岩堀敦志(富士精工株)</p> <p>106 挟み込み加工による薄リブ電極加工事例の紹介(第二報)<br/>榎本太一(株)牧野フライス製作所)</p>   | <p>204 エーミング面を用いた同時5軸制御加工用工具軌跡生成ソフトの開発<br/>石井照雄(株)ソフィックス)、武藤一夫(職業能力開発総合大学校)</p> <p>205 RFID(iCタグ)を活用した鍛造型在庫管理システムの開発<br/>松本高史、磯本圭介(株)NTTデータ)、松本文雄、並木利存(日産自動車株)</p> <p>206 知識NAVIシステムの加工分野への応用<br/>角尾龍彦、有吉秀穂(松下電器産業株)</p> | <p>304 鍛造性評価システムの開発<br/>小森誠、吉川雅宏、濱崎敬一(日産自動車株)、加藤進一郎、吉田広明、塩田哲郎(大同特殊鋼株)</p> <p>305 高性能熱間工具鋼による熱鍛型の寿命向上<br/>塩田哲郎、井上幸一郎(大同特殊鋼株)、太田明男、安居英則、小森誠(日産自動車株)</p> <p>306 金型用高靱性マトリックスハイスの実用事例解析<br/>中浜俊介、尾崎公造、松田幸紀(大同特殊鋼株)</p>   |   |
|   |  |  | <p>13:00~13:30<br/><b>型技術協会総会</b></p>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 13:30~14:00<br><b>協会賞贈賞式</b>  |
|  |  |  | 14:10~15:10<br><b>特別講演</b>  |
|  |  |  | 「 <b>キャノンの生産革新と<br/>金型革新への挑戦</b> 」<br>キャノン(株)<br>生産本部副本部長 高橋泰樹<br><br>司 会 今津英敏(日産自動車(株))<br><br>(内容の詳細は別紙をご覧ください) |

| 15:20~   |  |  |   |
|--|--|--|---|
| コパ`ンションホール1 (4F)                                       | コパ`ンションホール2 (4F)   | D 会議室 (6F)   | 小展示ホール (2F)   |
| 15:20~17:00<br><b>切削加工</b><br>座長 今泉英明(オーエスジー(株))       | 15:20~17:00<br><b>計測と品質保証</b><br>座長 高谷裕浩(大阪大学)                               | 15:20~17:20<br><b>放電加工</b><br>座長 大場信昭(三菱電機(株))   | 15:20~16:00<br><b>技術賞受賞特別講演</b>   |
| 107 ミラクルラッシュミルボールSRF形による長寿命加工<br>土谷雅哉、池永幸一(三菱マテリアル(株)) | 207 低荷重触針式機上形状測定システムの性能<br>- 一体化プローブの開発 -<br>渡邊裕、大森整、林偉民、森田晋也、劉慶(独)理化学研究所)   | 307 リニア放電加工自動化システムと3次元ソリッドモデル<br>緑川哲史(株)ソディック)   | 司 会<br>久田修義(トヨタ自動車(株))  |
| 108 粉末ハイスの直彫りを可能にした「エポックスーパーハードボール」<br>赤松猛史(日立ツール(株))  | 208 機上計測用レーザープローブの開発およびその性能評価<br>渡邊裕、大森整、林偉民、森田晋也(独)理化学研究所)                  | 308 リニアモーター駆動ワイヤ放電加工機の高速度高精度加工例<br>荒井祥次(株)ソディック)   | 「 <b>金型加工面品位向上のための<br/>NC データ解析ツール</b> 」<br>長谷部孝男(オークマ(株))                                  |
| 109 金型の高速高能率切削事例<br>永井保、斎藤益生(オーエスジー(株))                | 209 タッチプローブを用いた3次元自由曲面形状オンマシン測定「曲面形状測定機能」<br>川名啓、森規雄、倉橋康浩(株)牧野フライス製作所)       | 309 新ワイヤ放電加工機Wシリーズとその加工技術<br>根本政典(株)牧野フライス製作所)   | 「 <b>ナノマシンによる<br/>超微細・精密加工技術</b> 」<br>中元一雄(株)ソディック)   |
| 110 小径cBNボールエンドミルによる高能率仕上げ加工<br>石井聡(日進工具(株))           | 210 プレス型形状における、機上測定の実践について<br>松本隆一、三上純照(株)アルゴグラフィックス)、安澤豊、加藤孝一(東芝機械マシナリー(株)) | 310 超精密微細金型におけるワイヤ放電加工の最新技術と加工事例<br>安達章人、渡辺浩太郎、柴田淳一、榎本耕二(三菱電機(株))                            | 16:10~17:40<br><b>特別パネル討論会</b>  |
| 111 cBN 工具の開発とその実用化<br>福井雅彦、本橋健次、佐藤秀俊(東京工科大学)          | 211 海外動向 最新リバースエンジニアリング技術の実現<br>秋山成実、佐藤淳(丸紅ソリューション(株))                       | 311 細穴加工の市場ニーズと最新技術動向及び加工事例<br>後藤昭弘(三菱電機(株))、鈴木智、小田清仁(三菱電機エンジニアリング(株))、若杉道明(菱電工機エンジニアリング(株)) | 「 <b>金型メ - カの経営革新</b> 」<br>司 会<br>谷繁寿彦(株)ソディック)<br>山本敏郎(日本ユニシス・エクセリユーションズ(株))               |
|  |  | 312 逆テーパマイクロ穴の放電加工<br>内村明高、増沢隆久、藤野正俊(東京大学生産技術研究所)  | パネラー<br>東成生(株)東郷)<br>三宅和彦(株)セントラルファインツール)<br>平林健吾(株)サイベックコーポレーション)<br><br>(内容の詳細は別紙をご覧ください) |